聚辰半导体

聚辰半导体股份有限公司(Giantec Semiconductor Corporation)于2009年成立于上海张江高科技园区,是一家全球化的芯片设计高新技术企业,在美国硅谷、香港、台湾、深圳等地区设有子公司、办事处或销售机构,客户遍布台湾、韩国、香港、美国、日本、东南亚、欧洲等地区。聚辰半导体长期致力于为客户提供存储、模拟和混合信号集成电路产品并提供应用解决方案和技术支持服务。公司目前拥有EEPROM、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主要产品线,产品广泛应用于智能手机、液晶面板、蓝牙模块、通讯、计算机及周边、医疗仪器、白色家电、汽车电子、工业控制等众多领域。

公司将持续以市场需求为导向,以自主创新为驱动,对EEPROM、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片等现有产品线进行完善和升级,并积极开拓NOR Flash、电机驱动芯片等新产品领域,巩固在非易失性存储芯片领域的市场地位,丰富在驱动芯片等领域的产品布局,进一步提升公司产品的竞争力和知名度,扩大产品的应用领域,完善全球化的市场布局,逐步发展成为全球领先的非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片和电机驱动芯片等组合产品及解决方案供应商。

本文链接:https://dqcm.net/wenan/jcbdt-186996.html